

# 强于大市

## 半导体行业周报

全球晶圆厂设备支出预期持续增长，国产先进封装光刻机迎来新进展

国内光刻机零部件厂商华卓精科 IPO 成功过会，上海微电子推出新一代大视场高分辨率先进封装光刻机，半导体设备国产化进程再上台阶。SEMI 继续上调全球晶圆厂设备支出预期，意味着行业景气仍然高企，持续关注半导体设备、材料、封测等领域。

### 行业动态：

- **IPO 进度：**概伦电子、炬光科技分别于 9 月 22 日、23 日科创板首发上会。截止 2021/9/20，共有 98 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等，其中，刻蚀、去胶、退火等半导体设备商屹唐半导体提交注册；高性能模拟及混合信号集成电路设计商必易微、高功率半导体激光器芯片等设计商长光华芯、光刻机双工件台等半导体零部件商华卓精科等成功过会；射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片 SOC 设计商杰理科技申请获受理。
- **半导体设备：**全球晶圆厂支出预期持续增长，国产先进封装光刻机取得新进展。据 SEMI 最新研判，2022 年全球晶圆厂设备支出预计将近 1000 亿美元，标志着 2020 年开始持续罕见的三年增长。其中，Foundry 将占晶圆厂设备投资的一半左右，支出超过 440 亿美元；其次是 Memory，超 380 亿美元；DRAM 和 NAND 也都在 2022 年出现大幅增长，支出分别跃升至 170 亿美元和 210 亿美元。国产光刻机方面，上海微电子推出 SSB520 型新一代大视场高分辨率先进封装光刻机，可帮助晶圆级先进封装企业实现多芯片高密度互连封装技术的应用，满足异构集成超大芯片封装尺寸的应用需求，并已与多家客户达成销售协议，首台设备将于年内交付。同时，国产光刻机双工件台供应商华卓精科成功过会。
- **晶圆代工：**今年全球晶圆代工产值将创纪录。IC Insights 预计，今年全球晶圆代工产值有望首次突破 1000 亿美元，达到 1072 亿美元，同比增长 23%。2025 年全球晶圆代工总产值将达 1512 亿美元，5 年复合增速 12%。
- **封装测试：**多个封测项目建设陆续进入投产阶段。据集微网消息，尊阳集成电路封测产业基地项目总投资 40 亿元，建设周期为 2021-2026 年，达产后可形成年产 200 亿只标准化集成电路产品的产能。首期项目总投资 3.5 亿元，改造厂房面积 7000 平方米，近期将先进行设备调试工作，预计在 2022 年 5 月规模生产，形成 45.8 亿颗标准化集成电路封测产能。据经济观察网消息，康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司存储芯片封测工厂进入全面竣工阶段，厂务系统投入正式运行。鉴于目前马来西亚等地受疫情影响使得封测产能紧缺愈加严重，封测产能的投产将有望逐步缓解封测产能紧缺局面。

### 投资建议：

- **设备组合：**中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份；建议关注：晶盛机电、光力科技、神工股份。
- **材料组合建议关注：**沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份
- **功率半导体组合：**新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技
- **模拟建议关注：**圣邦股份、思瑞浦、卓胜微（射频）
- **MCU：**兆易创新；建议关注中颖电子
- **其他：**韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

### 风险提示

- 疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；半导体材料国内市场增速放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

### 相关研究报告

- 《半导体行业周报：上游陆续受益于晶圆扩产，下游承接成本压力》20210912
- 《半导体行业周报：晶圆代工厂持续扩产，材料及设备产业受益》20210905
- 《半导体行业周报：中报业绩全线向好，第三代半导体布局加速》20210830
- 《半导体行业周报：缺芯仍在持续，应用材料 Epi、热处理、CMP、离子注入、量测等产品的全年收入增速均将超 50%》20210824
- 《半导体行业周报：全球半导体设备交付期延长至 14 个月》20210817
- 《盛美半导体（ACMR）21Q2 业绩点评及会议纪要：坚定技术差异化、产品平台化、客户国际化战略，让客户从公司产品、技术中受益》20210813

中银国际证券股份有限公司  
具备证券投资咨询业务资格

### 半导体

证券分析师：杨绍辉  
(8621)20328569  
shaohui.yang@bocichina.com  
证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：余嫻嫻  
(8621)20328550  
yuanyuan.yu@bocichina.com  
证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

证券分析师：王达婷  
(8621)20328284  
dating.wang@bocichina.com  
证券投资咨询业务证书编号：S1300519060001

## 目录

拟 IPO 的半导体企业汇总 .....	4
半导体设备国产化情况 .....	7
行业数据回顾 .....	8
上周信息汇总 .....	12
半导体设备 .....	12
半导体材料 .....	12
晶圆代工 .....	13
封测 .....	13
模拟芯片 .....	13
风险提示 .....	14

## 图表目录

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/09/20) .....	4
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/09/20) .....	5
续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/09/20) .....	6
图表 2. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化情况及主要国内厂家 .....	7
图表 3. 全球半导体销售额当月值 .....	8
图表 4. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比 .....	8
图表 5. 日本半导体设备制造商出货额与同比 .....	9
图表 6. 美国与国内半导体指数对比 .....	9
图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 .....	9
图表 8. 美国与国内半导体指数对比(周度环比) .....	9
图表 9. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (周度环比) .....	9
图表 10. 申万半导体材料指数 .....	10
图表 11. 全球半导体级硅片出货量 .....	10
图表 12. 半导体器件封装材料进出口金额 .....	11
图表 13. 半导体器件封装材料进出口单价 .....	11
图表 14. 上周半导体相关个股周度涨跌幅 .....	11

## 拟 IPO 的半导体企业汇总

截止 2021/9/20，共有 98 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等，概伦电子、炬光科技分别于 9 月 22 日、23 日科创板首发上会。上周新增：

- **提交注册**：屹唐半导体（刻蚀、去胶、退火等半导体设备商）
- **成功过会**：必易微（高性能模拟及混合信号集成电路设计商）、长华光芯（高功率半导体激光器芯片等设计商）、华卓精科（光刻机双工件台等半导体零部件）
- **已受理**：杰理科技（射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片 SOC 设计商）

**屹唐半导体为半导体核心工艺设备商**。主营的干法去胶设备全球第 1、快速热处理设备全球第 2、干法刻蚀设备全球前 10，为综合实力拔尖的半导体设备提供商。

**必易微为电源管理芯片厂商**。主营电源管理芯片和电机驱动控制芯片的设计和制造，主要应用于 LED 照明、通用电源和家电及 IoT 等领域，功率覆盖 0.1W-200W。目前在产电源管理芯片规格型号超 600 个，已成为主要的全方案电源管理芯片供应商。

**长华光芯为半导体激光厂商**。聚焦半导体激光行业，主要产品包括高功率单管系列、高功率巴条系列和高效率 VCSEL 系列产品，其中高功率单管系列产品占营收比重最高。

**华卓精科为半导体装备关键零部件商**。国内首家光刻机双工件台厂商、技术领先的科技创新型公司，主营超精密测控装备部件及整机，精密运动系统为主要收入贡献业务。

**杰理科技为蓝牙芯片厂商**。聚焦于射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片（SOC）的研究、开发和销售，形成以蓝牙耳机芯片和蓝牙音箱芯片为主，同时涵盖智能物联终端芯片、健康医疗终端芯片、普通音频芯片等智能终端芯片的平台化发展格局。

**概伦电子为 EDA 供应商**。已经拥有制造类 EDA 技术、设计类 EDA 技术、半导体器件特性测试技术三大类核心技术及其对应的近二十项细分产品和服务。制造类和设计类 EDA 工具均能够支持 7nm/5nm/3nm 等先进工艺节点和 FinFET、FD-SOI 等各类半导体工艺路线。

**炬光科技为半导体激光厂商**。主要收入来源于半导体激光、激光光学业务，正拓展汽车应用和光学系统业务，已逐渐应用于先进制造、医疗健康、科学研究、汽车应用、信息技术五大领域。

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/09/20）

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	盛美股份	已注册	海通证券	2005	设备	清洗设备、FN、镀铜设备等
2	华海清科	提交注册	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
3	灿勤科技	提交注册	中信建投	2004	设计	微波介质陶瓷元器件
4	屹唐股份	提交注册	国泰君安、中金公司	2015	设备	刻蚀、去胶、退火
5	炬芯科技	提交注册	申万宏源	2014	设计	蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等
6	东芯股份	提交注册	海通证券	2014	设计	24nm NAND、48nm NOR
7	【苏州】国芯科技	提交注册	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和应用
8	安路科技	提交注册	中金公司	2011	设计	可编程逻辑器件 (FPGA)、可编程系统级芯片 (SoC)、及相关 EDA 软件工具和创新系统解决方案
9	翱捷科技	提交注册	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
10	创耀科技	提交注册	海通证券	2006	设计	通信芯片
11	芯导科技	提交注册	国元证券	2009	设计	功率半导体
12	云天励飞	提交注册	中信证券	2014	设计	AI 芯片
13	华大九天	过会	中信证券	2009	软件	EDA 软件
14	晶导微	过会	中信证券	2013	分立器件	二极管、整流桥等分立器件、集成电路系统级封装 (SiP)

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/09/20)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
15	必易微	过会	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
16	长光华芯	过会	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
17	华卓精科	过会	东兴证券	2012	零部件	超精密测控装备部件及整机, 首家光刻机双工件台厂商
18	天岳先进	过会	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
19	芯龙半导体	问询	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
20	中图科技	问询	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
21	希荻微	问询	民生证券、中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
22	英集芯科技	问询	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
23	江波龙	问询	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
24	东微半导体	问询	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
25	莱特光电	问询	中信证券	2010	材料	OLED 有机材料
26	唯捷创芯	问询	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
27	龙芯中科	问询	中信证券	2010	设计	CPU
28	纳芯微	问询	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
29	晶合集成	问询	中金公司	2015	设计	面板驱动芯片
30	炬光科技	问询	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品
31	思科瑞	问询	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
32	麦斯克	问询	国泰君安	1995	材料	硅片
33	甬矽电子	问询	平安证券	2019	封测	封测
34	比亚迪半导	问询	中金公司	2004	设计	功率半导体
35	赛微微	问询	国泰君安	2009	设计	电源管理芯片
36	概伦电子	问询 (*过会)	招商证券	2010	软件	EDA 软件
37	中微股份 (深圳)	问询	中信证券	2001	设计	混合信号 SoC
38	龙腾半导体	问询	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
39	盛景微	问询	光大证券	2016	设计	物联网控制芯片
40	臻镭科技	问询	中信证券	2015	设计	射频芯片、电源管理芯片
41	思特威	问询	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
42	天德钰	问询	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
43	奥比中光	问询	中信建投	2013	设计	深度引擎数字芯片、专用感光模拟芯片
44	好达电子	问询	安信证券	1999	设计	SAW Filter
45	烨映微	问询	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
46	沈阳拓荆	问询	招商证券	2010	设备	薄膜沉积设备
47	峰昭科技	问询	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
48	广立微	问询	中金公司	2003	软件/设备	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
49	路维光电	已申报	国信证券	2012	材料	掩模板
50	金海通	已申报	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机
51	毓昌科技	已申报	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
52	国微思尔芯	已申报	中金公司	2003	软件	EDA
53	杰理科技	已申报	中信建投	2014	设计	射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片 (SOC)
54	国博电子	完成上市辅导	招商证券	2010	设计	射频
55	艾森半导体	完成上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
56	江苏影速	上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
57	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
58	中科飞测	上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备
59	海光信息	上市辅导	中信证券	2014	设计	CPU
60	苏州赛芯微	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片
61	耐科装备	上市辅导	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
62	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券 \*概伦电子已于 2021 年 9 月 22 日过会

续图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/09/20)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
63	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
64	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
65	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导系列无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
66	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管
67	富创精密	上市辅导	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理
68	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
69	【杭州】国芯科技	上市辅导	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
70	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
71	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
72	南麟电子	上市辅导	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
73	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
74	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	一站式定制芯片及 IP 供应商
75	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
76	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
77	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
78	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
79	飞驒科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
80	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料
81	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
82	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片
83	汇成真空	上市辅导	东莞证券	2006	设备	真空应用设备
84	中巨芯	上市辅导	海通证券	2017	材料	电子湿化学品、电子特种气体、半导体前驱体
85	锐成芯微	上市辅导	华泰联合	2011	软件	IP 授权
86	新恒汇电子	上市辅导	平安证券	2017	封测/材料	晶圆测试减划、封装材料高精度蚀刻金属引线框架、物联网 eSIM 封装
87	映日科技	上市辅导	安信证券	2015	材料	靶材
88	绍兴中芯	上市辅导	海通证券	2018	代工	专注于功率、传感和传输应用, 特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工服务的制造商
89	有研半导体	上市辅导	中信证券	2001	材料	硅片
90	京仪装备	上市辅导	国泰君安	2016	设备	半导体温控装置系列 (Chiller)
91	盛科通信	上市辅导	中金公司	2019	设计	以太网交换芯片
92	思必驰	上市辅导	中信证券	2007	设计	AI 芯片
93	欣盛半导体	上市辅导	中信建投	2016	IDM	COF 封装显示驱动芯片
94	振华风光	上市辅导	中信证券	2005	IDM	高可靠半导体模拟集成电路
95	蓝箭电子	上市辅导	金元证券	1998	分立器件	三极管、二极管和场效应管, 同时对外承接半导体封装测试
96	兴福电子	上市辅导		2008	材料	电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品
97	燕东微	上市辅导	中信建投	1987	IDM	功率半导体、声光电传感器、声光电 ASIC、精密器件
98	新相微	上市辅导	中金公司	2005	设计	LCD 驱动芯片、CMOS SENSOR

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

## 半导体设备国产化情况

据国内主流 12 英寸产线的半导体工艺设备招投标数据统计，在 12 类主要半导体设备中，国产化程度最高的去胶设备国产化率为 82%，CMP、清洗、热处理、刻蚀、PVD 等设备的国产化率接近或超过 20%。镀铜、CVD、量测、离子注入、光刻、涂胶显影等设备的国产化程度仍处于较低水平。

图表 2. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化情况及主要国内厂家

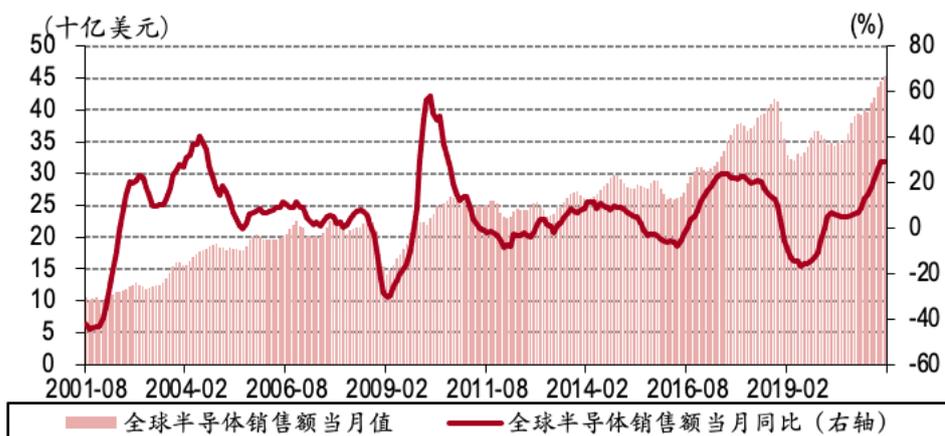
序号	设备名称	国产化率(%)	主要国内厂家
1	去胶设备	82	屹唐半导体
2	CMP 设备	26	华海清科
3	清洗设备	25	盛美半导体、北方华创、芯源微
4	热处理设备	25	北方华创、屹唐半导体、盛美半导体
5	刻蚀设备	22	中微公司、北方华创、屹唐半导体
6	PVD 设备	20	北方华创
7	镀铜设备	4	盛美半导体
8	CVD 设备	3	沈阳拓荆、盛美半导体
9	量测设备	3	上海精测、中科飞测、上海睿励、东方晶源
10	离子注入设备	1.5	中科信、万业企业
11	光刻设备	1	上海微电子
12	涂胶显影设备	1	芯源微

资料来源：中国国际招标网，中银证券

## 行业数据回顾

7月全球半导体销售额达454亿美元，同比增长29.0%，环比增长2.1%。据美国半导体产业协会SIA数据，7月全球半导体销售额继续保持增长，较6月销售额445亿美元增长2.1%。其中，7月份中国大陆半导体销售额为158.5亿美元，同比增长28.9%，环比增长1.2%。

图表3. 全球半导体销售额当月值



资料来源：万得，美国半导体产业协会，中银证券

7月北美半导体设备出货金额38.6亿美元，继续创新高。据SEMI统计，7月北美半导体设备出货金额又创新高，较6月的35.9亿美元提升4.5%，较2020年同期25.8亿美元上升49.8%。2021年1-7月份出货额的环比增幅分别为13.3%、3.5%、4.2%、4.7%、4.7%、2.3%、4.5%。

图表4. 北美半导体设备制造商出货额当月值与同比



资料来源：万得，SEMI，中银证券

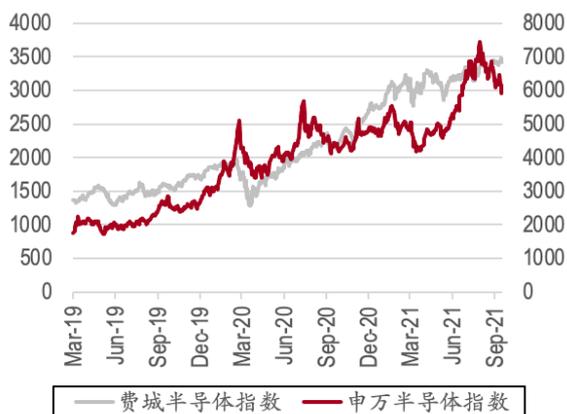
7月日本半导体设备出货金额2407亿日元，延续小幅下降趋势。据日本半导体制造装置协会统计，7月日本半导体设备出货金额继续回落，较6月的2495亿日元下降3.5%，相比于2020年同期1880亿日元仍上升28%。2021年1-7月份出货额的环比增幅分别为1.9%、3.7%、28.4%、17.2%、8.3%、-18.3%、-3.5%。

图表 5. 日本半导体设备制造商出货额与同比



半导体指数延续周度震荡，NAND 周度价格稳中带涨，DRAM 周度价格延续颓势。近一周申万行业半导体指数报 6,014.3，环比下跌 6.8%，延续前期震荡趋势，表明市场观点持续分化。费城半导体指数继续维持稳定，收报 3421.2 点，环比上涨 0.1%。近一周存储现货平均价略有上涨，开启稳中上涨趋势，NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC 价格环比上涨 0.8%，DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz 价格较上周下跌 1.2%，连续第 6 周录得下跌。

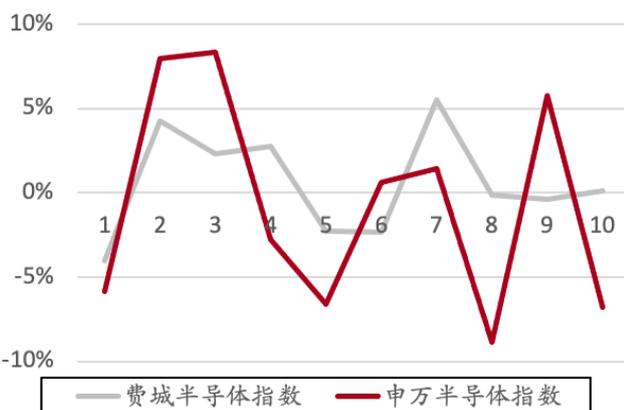
图表 6. 美国与国内半导体指数对比



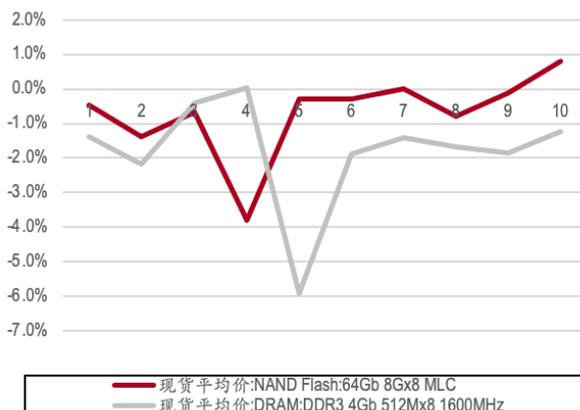
图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比



图表 8. 美国与国内半导体指数对比(周度环比)



图表 9. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比(周度环比)



上周申万半导体材料指数收报 9962.3 点，较上周下跌 5.5%。年初至今，申万半导体材料指数已上涨 65.5%，8 月整体指数呈高位震荡态势，9 月初开始出现剧烈回调并维持下跌趋势。

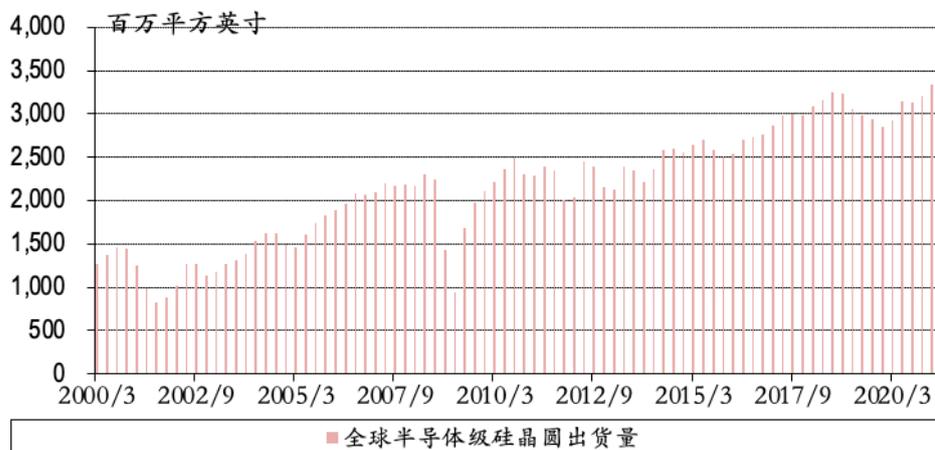
图表 10. 申万半导体材料指数



资料来源：万得，SEMI，中银证券

**硅晶圆：**根据 SEMI 数据，2021 年第二季度全球半导体级硅晶圆出货量达 3534 百万平方英寸，同比增长 12.1%，全球半导体级硅晶圆出货量屡创新高。

图表 11. 全球半导体级硅片出货量

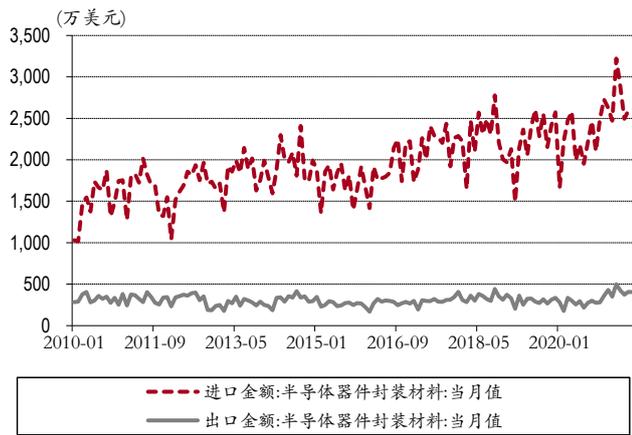


资料来源：SEMI，中银证券

**光刻胶：**飞凯材料在接受调研时表示，公司的 i-line 光刻胶以及 Barc 光刻胶配套材料目前正在下游相关晶圆厂做验证。一般验证通过后即可进入小批量供货阶段。

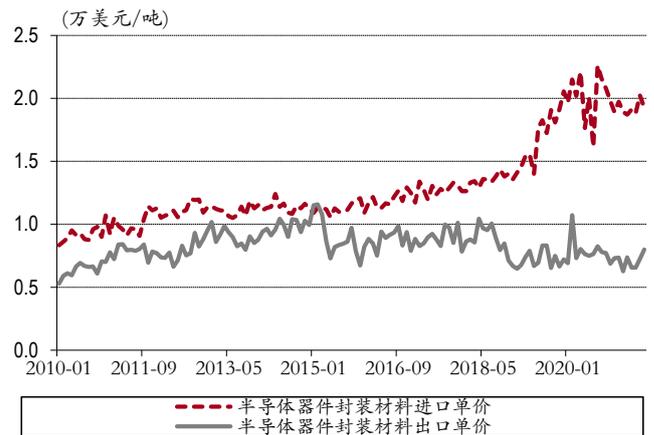
**封装材料：**根据海关总署数据，2021 年 7 月封装材料进出口数量差额进一步拉大，进口数量报 1,343.54 吨，较上月增加 4.9%，出口数量报 507.07 吨，较上月下降 9.6%。

图表 12. 半导体器件封装材料进出口金额



资料来源: 万得, 海关总署, 中银证券

图表 13. 半导体器件封装材料进出口单价



资料来源: 万得, 海关总署, 中银证券

图表 14. 上周半导体相关个股周度涨跌幅

代码	简称	周度跌幅 (%)	代码	简称	周度涨幅 (%)
300327.SZ	中颖电子	(17.01)	603290.SH	斯达半导	4.22
688536.SH	思瑞浦	(13.86)	688711.SH	宏微科技	0.46
688018.SH	乐鑫科技	(13.79)	603501.SH	韦尔股份	(1.36)
603068.SH	博通集成	(13.32)	688123.SH	聚辰股份	(2.22)
688286.SH	敏芯股份	(12.76)	688008.SH	澜起科技	(3.27)

资料来源: 万得, 中银证券

## 上周信息汇总

### 半导体设备

#### 【行业】2022 年全球晶圆厂设备支出预计将近 1000 亿美元，其中 Foundry 占晶圆厂设备投资的大部分

据 SEMI 最新研报，2022 年全球晶圆厂设备支出预计将近 1000 亿美元，将标志着从 2020 年开始罕见的连续三年增长。到 2022 年，Foundry 将占晶圆厂设备投资的大部分，支出超过 440 亿美元；其次是 Memory，超 380 亿美元；DRAM 和 NAND 也都在 2022 年出现大幅增长，支出分别跃升至 170 亿美元和 210 亿美元；Micro/MPU 投资约 90 亿美元；Discrete/Power 为 30 亿美元；Analog 为 20 亿美元；其它约 20 亿美元。

(资料来源：SEMI)

#### 【行业】上海微电子推出新一代大视场高分辨率先进封装光刻机，首台将于年内交付

据上海微电子装备集团官方消息，推出的新品光刻机主要应用于高密度异构集成领域，具有高分辨率、高套刻精度和超大曝光视场等特点，可帮助晶圆级先进封装企业实现多芯片高密度互连封装技术的应用，满足异构集成超大芯片封装尺寸的应用需求。通过升级运动、量测和控制系统，套刻精度提升至 $\leq 100\text{nm}$ ，并能保持长期稳定性。已与多家客户达成销售协议，首台将于年内交付。

(资料来源：上海微电子)

#### 【行业】三星正打造韩国半导体供应链

据日经新闻报道，三星电子正大力培育韩国国内的半导体相关设备和材料厂商，其在 1 年多时间里向 9 家主力企业共计出资 2762 亿韩元。其中包含半导体测试设备、晶圆研磨设备、真空泵设备、晶圆清洗相关设备、设备用陶瓷部件、掩膜保护零部件等设备类公司。

(资料来源：日经新闻)

#### 【大族激光】注册资本 1.3 亿元成立半导体公司

据企查查显示，大族精诚半导体(苏州)有限公司成立，注册资本 1.3 亿元人民币，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料研发等。该公司由大族激光 100% 控股。

(资料来源：企查查)

### 半导体材料

#### 【硅烷科技】拟建 500 吨/年半导体硅材料项目，总投资 3.6 亿元

据河南硅烷科技发展股份有限公司发布公告，硅烷科技主导研发的区熔级多晶硅项目已取得阶段性成果，该项目的研发样品分别在第三方专业检测机构和试用厂家进行了检测和试验，依据检测报告以及试验反馈情况，各项指标与国外进口产品基本一致。项目预算总投资 3.6 亿元，拟建设 500 吨/年高纯多晶硅（其中：区熔级多晶硅成品率占 60%，其它为电子级多晶硅），项目建设周期 12 个月。本项目企业自筹 30% 资金作为项目资本金，其余 70% 资金拟申请银行贷款。

(资料来源：硅烷科技)

### 【行业】晶盛机电孙公司鑫晶新材料第一只大尺寸石英坩埚成功下线

据集微网消息，晶盛机电全资孙公司内蒙古鑫晶新材料有限公司近日成功下线第一只大尺寸石英坩埚，标志着该公司石英坩埚项目正式启动投产。据悉，石英坩埚是拉制半导体级与光伏级大尺寸单晶硅棒必不可少的基础材料，是晶盛机电在半导体辅材耗材业务方面的新突破。公司以生产 28 至 40 英寸的石英坩埚为主，可为国内制造大直径硅片提供技术基础。

(资料来源：集微网)

### 晶圆代工

#### 【行业】2021 年半导体市场将增长 17.3%，预计将在 2022 年中期趋于稳定

据国际数据公司 IDC 最新预计，半导体市场预计将在 2022 年中期趋于稳定，更大规模的产能扩张将于 2022 年底开始。预计半导体市场 2021 年应该会增长 17.3%，而 2020 年的增长为 10.8%，到 2025 年将达到 6000 亿美元，2021-2025 年的复合年增长率为 5.3%。

(资料来源：IDC)

### 封测

#### 【行业】40 亿元江苏尊阳集成电路封测产业基地首期项目落成

据集微网消息，尊阳集成电路封测产业基地项目由江苏向阳集团有限公司与江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立，总投资 40 亿元，建设周期为 2021 年至 2026 年，达产后可形成年产 200 亿只标准化集成电路产品的产能。首期项目总投资 3.5 亿元，改造厂房面积 7000 平方米，近期将先进行设备调试工作，预计在 2022 年 5 月规模生产，形成 45.8 亿颗标准化集成电路封测产能。

(资料来源：集微网)

#### 【行业】20 亿元康佳盐城存储芯片封测项目或进入全面竣工阶段

据经济观察网消息，康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司存储芯片封测工厂进入全面竣工阶段，厂务系统投入正式运行。康佳芯云半导体科技盐城有限公司的存储芯片封装测试项目由康佳集团投资 20 亿元建设。

(资料来源：经济观察网)

### 模拟芯片

#### 【行业】德州仪器(TI)的模拟 IC 价格将从 10 月 1 日开始上涨 15%

据 digitimes 报道，笔记本电池模块制造商最近收到德州仪器(TI)的简短通知，称其必须将 9 月订单的发货时间推迟到 10 月，并且从 10 月 1 日开始，模拟 IC 价格将上涨 15%。

(资料来源：digitimes)

## 风险提示

**疫情影响超预期：**新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

**半导体设备国产化进程放缓：**新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

**半导体材料国内市场增速放缓：**半导体材料从世界范围来看是个增速较为缓慢的市场，中国市场在过去5年中CAGR达到了10%，远高于世界平均水平。若半导体材料进入下行周期，目前国内市场的增速将难以持续。

**美国进一步向中国禁售关键半导体设备：**由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

## 披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

## 评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

### 公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20% 以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在 -10%-10% 之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10% 以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

### 行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

## 风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

## 中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东  
银城中路 200 号  
中银大厦 39 楼  
邮编 200121  
电话: (8621) 6860 4866  
传真: (8621) 5888 3554

## 相关关联机构：

### 中银国际研究有限公司

香港花园道一号  
中银大厦二十楼  
电话: (852) 3988 6333  
致电香港免费电话：  
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065  
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065  
新加坡客户请拨打：800 852 3392  
传真: (852) 2147 9513

### 中银国际证券有限公司

香港花园道一号  
中银大厦二十楼  
电话: (852) 3988 6333  
传真: (852) 2147 9513

### 中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区  
西单北大街 110 号 8 层  
邮编: 100032  
电话: (8610) 8326 2000  
传真: (8610) 8326 2291

### 中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury  
London EC2R 7DB  
United Kingdom  
电话: (4420) 3651 8888  
传真: (4420) 3651 8877

### 中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号  
7 Bryant Park 15 楼  
NY 10018  
电话: (1) 212 259 0888  
传真: (1) 212 259 0889

### 中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z  
新加坡百得利路四号  
中国银行大厦四楼(049908)  
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587  
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371